

SURFACE MOUNT
GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 3.0 Amperes

FEATURES

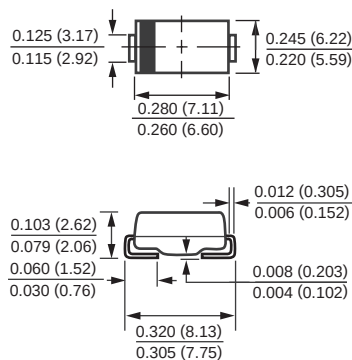
- * Glass passivated device
- * Ideal for surface mounted applications
- * Low leakage current
- * Metallurgically bonded construction
- * Mounting position: Any
- * Weight: 0.24 gram

MECHANICAL DATA

- * Epoxy : Device has UL flammability classification 94V-0



DO-214AB



Dimensions in inches and (millimeters)

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.

MAXIMUM RATINGS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	FM301	FM302	FM303	FM304	FM305	FM306	FM307	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	VRRM	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum RMS Voltage	VRMS	35	70	140	280	420	560	700	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	VDC	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum Average Forward Rectified Current TA = 75°C	IO	3.0							Amps
Peak Forward Surge Current IFM(surge): 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	IFSM	150							Amps
Typical Thermal Resistance	(Note 2) RθJL	10							°C/W
	(Note 3) RθJA	35							°C/W
Typical Junction Capacitance (Note 1)	CJ	60							pF
Operating and Storage Temperature Range	TJ, TSTG	-55 to + 150							°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	FM301	FM302	FM303	FM304	FM305	FM306	FM307	UNITS
Maximum Forward Voltage at 3.0A DC	VF	1.1							Volts
Maximum Full Load Reverse Current, Full cycle Average at TA=75°C	IR	30							uAmps
Maximum DC Average Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage		5.0							uAmps
		250							uAmps

NOTES : 1. Measured at 1.0 MHz and applied average voltage of 4.0VDC
2. Thermal resistance junction to terminal, 10.0X10.0mm² copper pads to each terminal.
3. Thermal resistance junction to ambient, 10.0X10.0mm² copper pads to each terminal.

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (FM301 THRU FM307)

FIG. 1 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

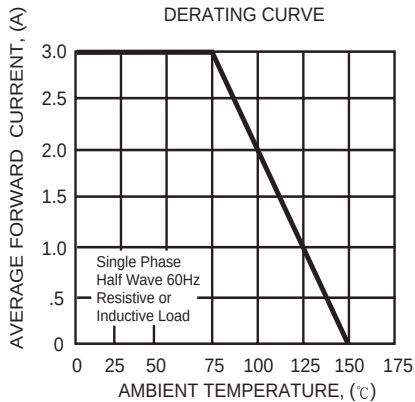


FIG. 2 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

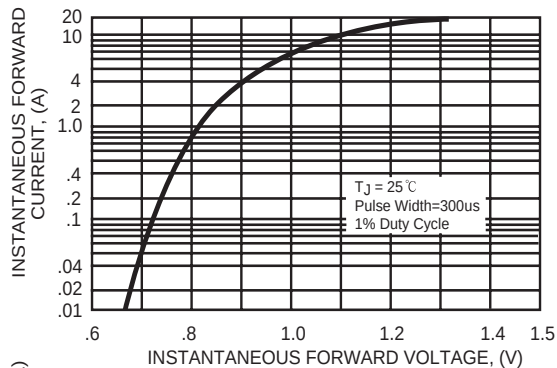


FIG. 3 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

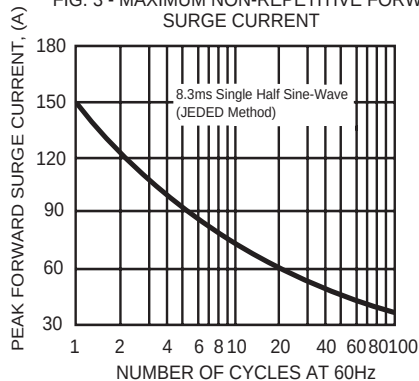


FIG. 4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

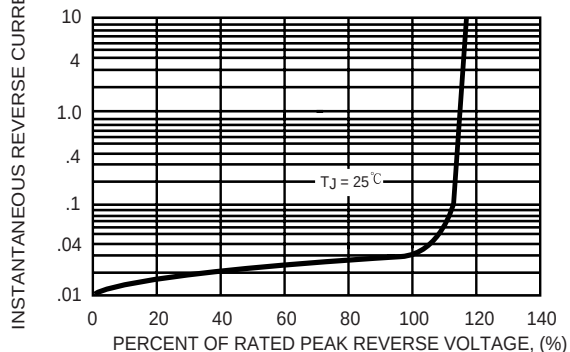
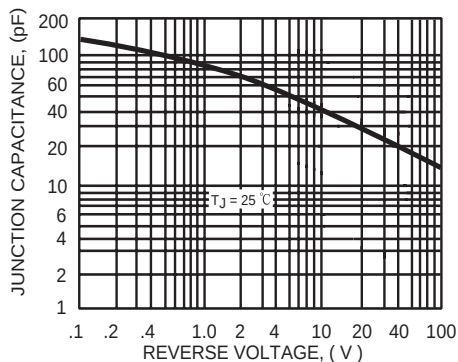
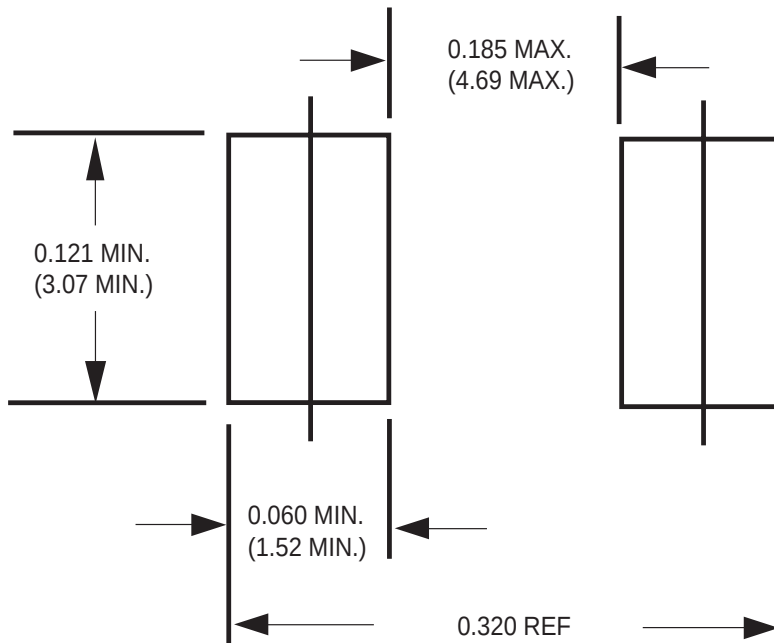


FIG. 5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



Mounting Pad Layout



Dimensions in inches and (millimeters)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9